

1、2、9号馆 平面图

2号馆 IC设计/封装测试



1号馆 先进材料/晶圆制造/设备/零部件



9号馆 晶圆制造/功率及第三代半导体



注: 图中

消防门(1*2m)

升降电梯(3*3m)

空调玻璃柱(2.68*2.68m)

消防栓(0.8*0.4*H1.8m)

平台下柱子(直径0.5m)